证券代码：688469　　证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☑业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与芯联集成（688469）2026年三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年10月22日 15:00-16:30
地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 赵奇 独立董事 陈琳 财务负责人 王韦 董事会秘书 张毅
投资者关系活动主要内容介绍	**1.赵总，您好！贵公司快速发展，营收规模年年都有增幅，今年内三期项目接近满产了，四期项目才开始建，明年下半年才试产，明年如何确保营收规模继续有增长幅度呢？另知，公司基本面相比上市之初已显著改善，但股价走势却没怎么表现，至今还在发行价附近徘徊，其他同类公司股价早已在天上了，请问贵公司在市值管理上有何打算，以回报投资者，是否效仿其他公司在二级市场上回购公司股份呢？** 答:尊敬的投资者您好，关于营收增长，2026年前三季度公司实现营业收入77.58亿元，同比增长43.09%；其中第三季度营业收入31.96亿元，同比增长65.87%。公司核心产品市场需求持续旺盛、订单饱满，行业整体呈现供不应求格局。在产能保障方面，公司8英寸碳化硅产线正从7,000片/月扩产至1.5万片/月，12英寸模拟IC产线计划从5万片/月提升至明年的7-8万片/月；四期项目作为后续产能储备，计划2027年底投产。伴随SiC业务市场份额持续稳步提升，车规、工控、AI等高壁垒领域的量产项目持续落地，模拟IC业务量产规模持续扩大，公司有信心保持营收持续增长。 关于市值管理，公司高度重视市值管理与投资者回报，将持续聚焦主业、

	提升经营质量与盈利能力，以良好的经营成果回报投资者。股份回购属于公司重大事项，如涉及应披露事项，公司将严格按照监管规定履行审议程序及信息披露义务，请投资者以公司公告为准。感谢您对公司的关注。 **2.赵总，您好！能否对贵司光互连板块的发展前景及未来两个季度的利润预期做个展望？目前各主营板块的在手订单如何？公司未来的业绩亮点主要在哪几个方面？** 答:尊敬的投资者您好，公司核心产品市场需求持续旺盛，目前公司在手订单饱满，产能利用率保持在较高水位。随着产品结构持续优化、规模效应释放、产品量价齐升，以及明年8英寸碳化硅产线扩产、12英寸模拟IC产线爬坡等带来产能的扩充，将进一步推动公司营业收入及毛利率的有效提升。 关于光互连板块，公司完整布局了涵盖光芯片、电芯片、异质集成及光交换四大模块，向市场提供国内稀缺的全链条光互连解决方案，卡位NPO/CPO下一代高速光互连赛道，发展前景广阔。感谢您对公司的关注。 **3.请详细展开说明下贵司在10月19日投资者关系活动记录表中描述的贵司“向市场提供国内稀缺的全链条光互连解决方案”中为何“稀缺”的说法，谢谢！** 答:尊敬的投资者您好，公司全链条光互连解决方案的竞争优势主要体现在：一是公司完整布局VCSEL、InP、硅光、TFLN（薄膜铌酸锂）、SiGe、MEMS OCS，涵盖光芯片、电芯片、异质集成及光交换四大模块，是国内少数具备端到端光互连全流程代工能力的企业之一；二是面向NPO/CPO最关键的三维集成需求，公司拥有丰富的TSV工艺量产经验，可提供12英寸TSV硅通孔、TCB晶圆级异质堆叠、Cu Hybrid bonding（铜混合键合）等集成工艺，可在晶圆层面实现光电芯片高密度堆叠，缩短信号路径、降低功耗、减小封装尺寸。 在光芯片层面，公司推进12英寸Si/SiN光波导、Ge探测器平台的多代工艺节点，并布局VCSEL、InP激光器及TFLN调制器路线，同步研发MicroLED新型光源；在电芯片层面，依托12英寸SiGe平台自研高速TIA跨阻放大器与激光驱动器，可实现光电协同设计，在同一工艺生态下完成接口匹配与寄生参数优化。感谢您对公司的关注。 **4.请问针对机器人具身智能行业方面贵司的产品和业务情况如何？目前跟哪些相关行业的头部企业或者大客户有业务合作？** 答:尊敬的投资者您好，在具身智能领域，公司可为机器人提供MEMS传感器芯片、激光雷达芯片、惯性导航单元（IMU）芯片、驱动芯片及MCU等核心硬件，并提供高度集成的系统级套片方案。公司客户结构呈多元化与均衡化态势，具体业务合作情况请以公司公告及定期报告披露信息为准。感谢您对公司的关注。

	5.董事长您好，我有三个问题想请教：1、三季报中合同负债为5.42亿元，较上年末有显著增长。这是否意味着公司对明年的订单储备和高增长充满信心？全年100亿元的目标是不是保守估计？ 2、半年报时公司提到AI业务上半年同比增长84.31%，预计全年收入占比超10%。想请问前三季度AI业务的增长态势如何？AI服务器相关的功率器件、电源管理芯片的客户验证和量产导入有没有新的突破？ 3、总投资约200亿元的12英寸数模混合芯片生产线项目，当前资本金到位和项目建设进度如何？公司对该项目的量产节奏和长期盈利预期是怎样规划的？ 答:尊敬的投资者您好，关于您的三个问题：1、公司2026年三季报合同负债为5.42亿元，较上年末的2.27亿元增长约138%，主要系客户预收款增加。核心产品市场需求旺盛、客户合作持续深化、订单饱满及产能逐步释放，将助力公司营收持续增长。2、关于AI业务，前三季度AI业务保持高速增长态势。在AI算力电源方面，公司多款SiC功率器件、SGT低压MOSFET在头部客户送样验证，55nm DrMOS已通过验证。3、截至目前，12英寸数模混合芯片生产线项目（四期项目）各股东认缴848,312.417万元资本金已全部实缴，计划于2027年底投产。感谢您对公司的关注。 **6.王总您好，我有三个问题想请教：1、公司前三季度营收同比增长超43%，Q3单季营收增速接近66%，盈利大幅超预期的驱动因素有哪些？三季度全品类涨价的落地效果如何？ 2、公司前三季度毛利率提升至19.65%，Q3单季毛利率更是接近30%，毛利率的提升非常显著。想请问当前公司的盈利修复处于什么阶段？后续综合毛利率继续提升的空间还有多大，主要的提升抓手是什么？ 3、前三季度公司资产减值损失约7.44亿元，请问存货跌价准备/合同履约成本减值准备的情况如何？后续相关减值是否可能会减少？** 答:尊敬的投资者您好，关于您的三个问题：1、公司营收增长主要系产品量价齐升、产品结构不断优化，叠加规模效应显现、整体运营效率持续优化、折旧摊销占营业收入比重下降等多重因素对净利润产生主要贡献。此外技术授权业务也产生正向影响。涨价已在三季度逐步显现，四季度全面释放。2、公司盈利能力依托高附加值产品的不断拓展、产品持续迭代等带来的产品盈利能力的提升，客户和市场的不断开拓，以及生产精益管理等降本增效举措的落地，不断提升公司的盈利能力。3、根据会计准则要求并出于谨慎性考虑，公司资产减值主要为对原材料和在产品的减值计提。鉴于公司产品盈利能力的逐步提升，对应产品实现销售后将相应进行转销，减值率将逐步下降。感谢您的关注。 **7.请问公司向四期出售的专利和技术授权的12亿收入，二季度已确认了2.7亿多，剩余金额后续是如何计划确认掉这些收益的？比如是一次还是多**

	次，26年年度内还是会放到27财年等？三季报中有提到截至报告期末，公司已完成了上述出售资产及授权事项的交割。 答:尊敬的投资者您好，根据公司2026年第三季度报告，为保障12英寸数模混合芯片制造项目平稳过渡与持续创新，公司及其子公司向芯联先进转让并同步授权实施配套专利及非专利型专有技术，交易定价为12.11亿元（不含增值税），截至报告期末公司已完成上述出售资产及授权事项的交割。相关收入确认遵循《企业会计准则》及公司会计政策，目前已确认完毕。感谢您对公司的关注。 **8.FAB工厂的工作特殊性导致人员流动比较频繁，请问芯联是通过什么方式降低员工流动性？或者说针对高流动性有哪些措施保证人员的稳定，从而保障不会影响到产能和产品质量，企业能稳定发展。** 答:尊敬的投资者您好，为保障芯联员工的稳定留任，公司从股权激励、薪酬与工会福利、生活关怀以及人才培养等多个方面给予员工关怀：股权激励方面，公司实施限制性股票、期权等长期激励计划；薪酬与工会福利方面，公司给予员工充分的晋升空间，为提升员工生活幸福感，公司工会组织丰富的业余活动；同时公司注重员工个人发展，给予员工多样化培训服务。在保证人员稳定的前提下，推进产线自动化、智能化升级，多措并举保障人员稳定与产能、质量的持续提升，支撑公司稳健发展。感谢您对公司的关注。 **9.今年第四季度业绩预测，明年前景怎样？** 答:尊敬的投资者您好，随着AI等新兴应用领域带来的市场需求，公司在SiC、模拟IC等方面的收入将保持快速增长，叠加公司全品类调价的落地，四季度营收、毛利率将继续保持上升通道。展望未来，公司持续构建一站式系统技术平台的差异化竞争优势，在AI算力电源、AI终端应用、具身智能等细分赛道打造AI时代的增长动能。2027年公司8英寸碳化硅产线将扩产至1.5万片/月，12英寸模拟IC产线将提升至7-8万片/月，产品结构优化与规模效应释放将持续推动公司保持营收增长趋势。感谢您对公司的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年10月22日